

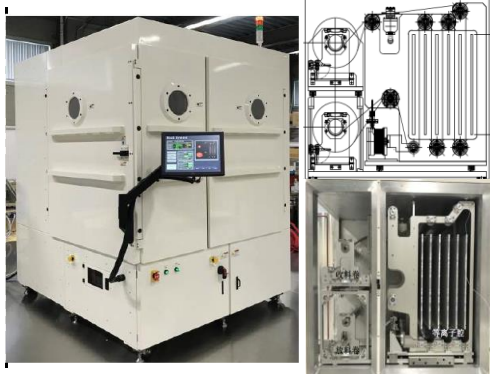


Nordson March Plasma 详细资料

全球等粒子设备领导者，Nordson March公司拥有近30年的PCB等离子系统的研发、生产和应用的经验，NORDSON MARCH PLASAM广泛的应用于HDI, RFLX, FPC, 高层板，封装基板的通盲孔处理、高厚径比的高层板去钻污、特殊材料的活化、改性等等。全球TOP50强有超过95%的PCB工厂使用March Plasma System。全部采用专利的PAWER-PAWER 电极

设备型号	垂直式 Via 系列				水平式等离子	最新第二代卷到卷RollVia
	ProVia	MaxVia	MaxVia-Plus	ModVIA	Flex-Via-Plus	
主要技术 参数和应 用						
	用于硬板、软板以及软/硬复合板；封装基板				薄板激光钻孔后碳去除；除胶渣；	RTR软板/软硬复合板
	激光钻孔后碳去除；除胶渣；				PTFE的混压材料的活化：提高亲水性	卷到卷各类软板和软板材料的表面活化，表面清洁。
	表面改性处理，提高表面张力，				表面清洁，表面粗化；干膜/绿油显影后去除残留物	卷到卷各类软板的通/盲孔的孔内除胶渣，孔壁清洁和面清洁
	最高的均匀性：>80%				最高的均匀性：>90%	
	一生产板厚：0.1-12.5mm				孔DESMEAR <0.5mm, 表面厚度无限制，水平放板	单边上下料，卷轴两端支撑。
产能	运行成本低 CF4 2-8%				CF4 5-8%	
	13格	15格	4-8格	左右各15格	3-7格	
	13片	26片	8-16片	30片/循环	0.1-3米/分钟	
最大尺寸	25X32"	25X22"	25X22"	25X22"	20X30"	宽 250mm , 500mm
	25X32"	25X44"			20X30"	/

备注： 1. 所有的价格是标准设备的价格仅供参考，具体的价格以配置要求正式报价为准。

2. 相关技术参数岁设备的更新可能有调整， 最终以双方签署的技术要求为准

地址：香港灣仔軒尼詩道308號集成中心2107室

办公室：：珠海市香洲区翠珠三街2号广德办公社5层C区502

Tel: +86 13902531797 +852 68581098 0756-8518077

FAX: 0756-8538067

E-Mail: bill.wang@u-effort.com